

第1回半導体デバイスプロセス技術基礎講座 2023

【化学機械研磨技術（CMP）概要と半導体洗浄技術の基礎とCMP洗浄とは】

主催：大阪公立大学 協創研究センター 半導体超加工・集積化技術研究所

https://www.omu.ac.jp/orp/org/crc/semicon_tech/

協賛（含予定）：エレクトロニクス実装学会、応用物理学会シリコンテクノロジー分科会、化学工学会エレクトロニクス部会、CVD研究会

後援（含予定）：近畿経済産業局

日時：2023年12月20日（水）16:00～18:50

開催場所：大阪公立大学 I-site なんば 2階 C2&C3

<https://www.omu.ac.jp/isite/access/>

講師：株式会社 荏原製作所 精密・電子カンパニー 今井 正芳 氏

講演概要：半導体デバイスのウェーハプロセスでは、絶縁膜、配線材料（タングステン、銅など）の化学機械研磨技術（CMP）は必須になっている。止まることの無いデバイスの微細化において、CMP技術のより精密な制御が求められており、スラリー、装置、計測、シミュレーション等が急速に進展している。一方、スラリーを用いるCMPでは、洗浄技術が極めて重要で有り、様々な状況下におけるナノ粒子や汚染源の挙動の解明と制御が求められている。本セミナーでは、業界の第一人者である今井氏が化学機械研磨技術（CMP）概要と、CMPに基づく洗浄技術について、一般半導体洗浄との違いを紹介しながら、基礎技術、課題について概説する。

プログラム（若干時間が前後することがあります）

16:00～16:10 開催の挨拶

16:10～18:45 セミナー（途中休憩と質疑応答を含む）

18:45～18:50 閉会

- * 定員 100名(先着申込順)
- * 参加費「無料」
- * 申し込みは、右のQRコードもしくは下記のURLからお願いします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciSTHQxECy3dpY5a-WXkEdOBWEEOVc3Rg8oSi_L3z2siZ9xA/viewform?vc=0&w=1&flr=0&u;sp=mail_form_link&pli=1

* 申し込み締め切り：2023年12月15日（金）

* 問合先：大阪公立大学 協創研究センター 半導体超加工・集積化技術研究所

TEL.: 072-254-9821 e-mail: semicon.tech.omu@gmail.com

* 謝辞 本講座運営の一部は公益財団法人 東京応化科学技術振興財団から補助されています



申し込み用QRコード

